

<<日中中日半导体制造技术用语词典>>

图书基本信息

书名：<<日中中日半导体制造技术用语词典>>

13位ISBN编号：9787811187731

10位ISBN编号：7811187736

出版时间：2011-6

出版时间：上海大学出版社

作者：林少霖

页数：382

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

编写说明

本词典为“日中中日半导体制造技术用语词典”，是提供给从事研究和开发半导体技术、阅读日语半导体制造技术类书籍和杂志、学习专业知识、从事该类科技文献和技术资料翻译工作者作为专业用语参考的工具书。

本词典共收录了大约3,500条有关半导体制造方面的专业词汇，具有从日文或中文词条中查阅解释的双向功能。

收词范围

本词典主要收集了有关半导体制造技术方面的用语，包括半导体设计、材料、硅氧化、光刻刻蚀、扩散和离子注入、掺杂、晶体生长、曝光、光刻胶、涂胶显影、气相沉积、晶片清洗、切割、研磨、芯片热处理、溅射、键合、封装、印刷、光学、机械等工艺及外观检验、性能检验等基本专业词汇。

编排方法

1.“日中半导体制造技术用语”部分按照日语50音图顺序的“あ、か、さ、た、な、は、ま、や、ら、わ行”规则进行排序，并且按照50音图的其他规则顺序可继续查阅单词。日文词条的中文解释可从该部分中查阅。

2.“中日半导体制造技术用语”部分根据中文的汉语拼音顺序进行排序。从中文词条查阅日文解释时，可从该部分中查阅。

3.英文字母开头的词条和英文缩写词条可从“英文字母开头的日中半导体制造技术用语”部分中查阅。该部分根据英文字母顺序排列。

4.日文专业用语是英文外来语的，同时用英文并列标注，以便使用者可以参考英文解释。

5.在日语片假名单词中，会有一些单词标注长音或不标注长音，这只是习惯上的不同，两者均为正确。例如：

センサー=センサ メーカー=メーカー

6.在部分专业用语中，中文解释上也会有所差异，例如本词典中“エッチング”解释为“刻蚀”的，但该单词也有解释为“刻蚀”的，这两种解释均为正确。本词典统一解释为“刻蚀”。

7.某个单词有若干个中文解释时，本词典用顿号“、”将几个解释隔开，查阅者可以根据文章内容选择合适的解释。

作者简介

1983年毕业于上海外国语学院日语专业后，担任上海宝山钢铁厂指挥部日语翻译及宝钢总厂化产厂日语翻译。

1986年进入上海对外服务公司，曾被派遣到日本大和证券上海事务所、住友商事上海事务所从事金融证券、产业机械设备、船舶发动机及机床类对中国出口贸易业务。

1990年赴日本大阪大学研究中国私有经济发展、中国农村经济及乡镇企业经济发展课题。

1993年就职于日商岩井重机械部从事炼钢厂、成套设备等对中国出口业务。

回国后曾担任美资制造企业总裁执行秘书及日资人才公司经理。

1999年4月独立创办上海杰业咨询翻译有限公司。

书籍目录

编写说明

日中半导体制造技术用语

中日半导体制造技术用语

英文字母开头的日中半导体制造技术用语

编辑推荐

《日中中日半导体制造技术用语词典》编辑推荐：日中中日半导体制造技术用语词典；是外资企业半导体制造专业人士的必备词典！

！

《日中中日半导体制造技术用语词典》中收录了半导体设计、材料、硅氧化、光刻、刻蚀、扩散和离子注入、掺杂、晶体生长、曝光、光刻胶、涂胶显影、气相沉积、晶片清洗、切割、研磨、芯片热处理、溅射、键合、封装、印刷等词汇，是专业人士从事半导体业务的最佳帮手。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>